

## 深圳市大为创新科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资并由其向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并由其向全资孙公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）增资 14,000 万元人民币，再由大为创芯向其全资子公司芯汇群科技香港有限公司（以下简称“芯汇群香港”）增资 2,000 万美元。具体情况如下：

#### 一、本次增资情况概述

在当前存储市场量价齐升的行业机遇下，公司基于在半导体存储领域已构建的高效交付网络与业务成果，进一步加大投入，把握市场机遇、支持业务拓展并提升核心竞争力。

公司拟以自有资金向全资子公司大为创芯增资 14,000 万元人民币，再由大为创芯以自有资金向其全资子公司芯汇群香港增资 2,000 万美元。本次增资完成后，大为创芯的注册资本将由 3,000 万元人民币增至 17,000 万元人民币，芯汇群香港的注册资本将由 100 万美元增至 2,100 万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。其中，向芯汇群香港增资事项尚需经过商务主管部门、国家发展和改革委员会、外汇管理部门等相关主

管部门备案/核准。

二、本次增资对象基本情况

- (一) 深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 1、公司名称：深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144030057198260XB
- 3、法定代表人：连浩臻
- 4、注册资本：3,000 万元人民币
- 5、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406
- 6、成立日期：2011 年 3 月 23 日
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：一般经营项目：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批[2013]400019 号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。许可经营项目：无。
- 9、股东及持股情况：公司持有大为创芯 100%股权，为公司全资子公司。
- 10、主要财务数据（合并口径）：

单位：人民币元

| 序号 | 项目        | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|----|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 资产总额      | 161,178,187.15            | 194,520,810.2             |
| 2  | 负债总额      | 108,621,956.17            | 149,436,390.65            |
| 3  | 或有事项涉及的总额 | -                         | -                         |
| 4  | 净资产       | 52,556,230.98             | 45,084,419.55             |
| 序号 | 项目        | 2025 年 1-9 月<br>(未经审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(经审计)    |
| 1  | 营业收入      | 794,218,932.86            | 875,842,087.79            |
| 2  | 利润总额      | 9,326,986.35              | 474,567.34                |
| 3  | 净利润       | 8,584,871.83              | 352,044.44                |

11、信用情况：大为创芯不属于失信被执行人。

(二) 芯汇群科技香港有限公司

1、公司名称：芯汇群科技香港有限公司

2、商业登记号码：72779659

3、公司编号：3027707

4、注册资本：100 万美元

5、办事处地址：19H MAXGRAND PLAZA, NO.3 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, HONG KONG

6、成立日期：2021 年 3 月 15 日

7、企业类型：私人股份有限公司

8、股东及持股情况：大为创芯持有其 100%股权，为公司全资孙公司。

9、主要财务数据：

单位：人民币元

| 序号 | 项目        | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|----|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 资产总额      | 117,615,415.34            | 98,982,370.11             |
| 2  | 负债总额      | 52,451,882.40             | 36,681,898.27             |
| 3  | 或有事项涉及的总额 | -                         | -                         |
| 4  | 净资产       | 65,163,532.94             | 62,300,471.84             |
| 序号 | 项目        | 2025 年 1-9 月<br>(未经审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(经审计)    |
| 1  | 营业收入      | 628,681,080.73            | 518,703,250.83            |
| 2  | 利润总额      | 4,184,486.91              | 1,236,363.37              |
| 3  | 净利润       | 3,608,153.28              | 1,123,769.63              |

10、信用情况：芯汇群香港不属于失信被执行人。

三、本次增资的背景、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资的背景和目的

近年来，随着大数据、人工智能、物联网、5G 通信等新一代信息技术的快速发展，全球数据量呈爆发式增长，市场对高性能、高可靠性半导体存储产品的

需求持续提升，行业发展前景广阔。公司半导体存储业务依托香港地区发达的物流体系与便利的进出口优势，构建了高效的全球交付网络：国内客户通过香港分支机构开展采购，国际客户则由香港货代公司提供专业物流支持，形成了符合行业惯例、快速响应客户需求的交付模式，有效保障了海外业务的顺畅运行。

为把握半导体产业发展战略机遇，深化公司在存储领域的产业布局，助力子公司业务拓展，提升核心竞争力，公司拟对全资子公司进行增资。本次增资将有效增强子公司资本实力，提升其业务规模与可持续发展能力，符合公司整体发展战略与长远利益。

## **（二）本次增资存在的风险**

本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧及经营管理等方面的风险，投资收益存在不确定性，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。本次向芯汇群香港增资事项尚需经过商务主管部门、国家发展和改革委员会、外汇管理部门等相关主管部门的备案或核准，实施结果和完成时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## **（三）对公司的影响**

本次增资完成后，大为创芯仍为公司全资子公司，芯汇群香港仍为公司全资孙公司，公司合并财务报表范围不会发生变化。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **四、备查文件**

1、《第六届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 12 日